

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 山村 章
 (JASDAQ・コード6890)
 問合せ先 執行役員 IR室長 佐藤 昭広
 (03-3281-8186)

当社の特定子会社に関する開示漏れについて

このたび、当社連結子会社である香港第一半導体科技有限公司の増資の決議に伴い、特定子会社の異動に関する適時開示の準備をしていたところ、既に同社の資本金が当社の資本金の額の100分の10以上となっており、特定子会社に該当していたにもかかわらず、特定子会社異動に関する上場規程に基づく開示並びに有価証券報告書における特定子会社の分類表記が過去においてされていない事実が判明しました。

当該事実の判明により、今般当社の全連結子会社41社で開示漏れの有無を社内調査した結果、当社の特定子会社は10社(2019年3月31日現在)のうち、上場規程に基づく開示漏れは、9社(上記先を含む)、有価証券報告書における特定子会社の分類表記未記載は1社(上記先)あることが判明しました。

今回、開示が漏れておりました特定子会社につきまして以下の通りお知らせ申し上げますとともに、事後での開示となりましたことをお詫び申し上げます。

記

1. 適時開示漏れの特定子会社(9社)の概要(2019/3/31現在) : 詳細は別紙の一覧表をご覧ください。

名 称	設立年月日	所在地	代表者の役職・氏名	事業内容	資本金 (千中国元/千香港ドル/千米ドル)
1 杭州大和熱磁電子有限公司	1992/1/31	中国浙江省	董事長 山村 章	半導体等装置関連事業、電子デバイス事業、太陽電池事業	677,512 (10,325百万円)
2 杭州大和江東新材料科技有限公司	2014/7/18	中国浙江省	董事長 賀 賢漢	半導体等装置関連事業	147,305 (2,244百万円)
3 杭州中芯晶圓半導体股份有限公司	2017/9/28	中国浙江省	董事長 賀 賢漢	半導体等装置関連事業	1,557,764 (23,740百万円)
4 上海申和熱磁電子有限公司	1995/5/17	中国上海市	董事長 山村 章	半導体等装置関連事業、電子デバイス事業、太陽電池事業	1,241,187 (18,915百万円)
5 上海漢虹精密機械有限公司	2005/3/11	中国上海市	董事長 賀 賢漢	太陽電池関連事業その他	266,051 (4,054百万円)
6 寧夏銀和新能源科技有限公司	2011/4/20	中国銀川市	董事長 賀 賢漢	太陽電池関連事業	319,500 (4,869百万円)
7 寧夏銀和半導体科技有限公司	2015/12/14	中国銀川市	董事長 賀 賢漢	半導体等装置関連事業	200,000 (3,048百万円)
8 香港第一半導体科技股份有限公司	2008/3/28	香港	董事長 賀 賢漢	太陽電池関連事業	359,072 (4,879百万円)
9 Ferrotec (USA) Corporation	1968/10/15	米国	President&CEO 宮永英治	半導体等装置関連事業 電子デバイス事業	41,611 (4,425百万円)

(注1) 円換算レートは、2019年8月5日時点の三菱UFJ銀行公表仲値為替レート CNYJPY=15.24/HKDJPY=13.59/USDJPY=106.35 を使用しております。(百万円未満切り捨て)

2. 原因と再発防止策

今回の件につきましては、当該適時開示基準の誤認並びに相互確認体制の未徹底により発生したものと認識しております。今後、かかることが無いよう適時開示基準の社内勉強会並びに相互確認体制の強化により、再発防止に努めてまいります。

3. 今後の見通し

本件による2020年3月期の連結業績に与える影響は無いものと認識しておりますが、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上

※用語説明：「特定子会社とは」

企業内容等の開示に関する内閣府令（昭和四十八年一月三十日大蔵省令第五号）第二項第三号に規定する特定子会社とは、次の各号に掲げる特定関係のいずれか一以上に該当する子会社をいいます。

- 一 当該提出会社の最近事業年度に対応する期間において、当該提出会社に対する売上高の総額又は仕入高の総額が当該提出会社の仕入高の総額又は売上高の総額の百分の十以上である場合
- 二 当該提出会社の最近事業年度の末日（当該事業年度と異なる事業年度を採用している会社の場合には、当該会社については、当該末日以前に終了した直近の事業年度の末日）において純資産額が当該提出会社の純資産額の百分の三十以上に相当する場合（当該提出会社の負債の総額が資産の総額以上である場合を除く。）
- 三 資本金の額（相互会社にあつては、基金等の総額。）又は出資の額が当該提出会社の資本金の額（相互会社にあつては、基金等の総額。）の百分の十以上に相当する場合

<別紙 1/3>

(1) 名 称	杭州大和熱磁電子有限公司			杭州大和江東新材料科技有限公司			杭州中芯晶圓半導體股份有限公司					
(2) 所 在 地	中国浙江省			中国浙江省			中国浙江省					
(3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	董事長 山村 章			董事長 賀 賢漢			董事長 賀 賢漢					
(4) 事 業 内 容	半導体等装置関連事業、電子デバイス事業、太陽電池事業			半導体等装置関連事業			半導体等装置関連事業					
(5) 資 本 金	677,512千中国元			147,305千中国元			1,557,764千中国元					
(6) 設 立 年 月 日	1992/1/31			2014/7/18			2017/9/28					
(7) 議 決 権 の 所 有 割 合 () 内 は 間 接 所 有 の 割 合	100.00%			100.00%			100.00% (23.75%)					
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社100%出資の連結子会社			資 本 関 係	当社100%出資の連結子会社			資 本 関 係	間接所有23.75%を含む当社100%出資の連結子会社		
	人 的 関 係	当社の取締役2名が同社の董事を兼任			人 的 関 係	当社の取締役1名が同社の董事を兼任			人 的 関 係	当社の取締役3名が同社の董事を兼任		
	取 引 関 係	当社は資材等の購買代行、債務保証をしています			取 引 関 係	当社は資材等の購買代行、債務保証をしています			取 引 関 係	当社は資材等の購買代行、債務保証をしています		
(9) 最近3か年の経営成績及び財政状態	(千中国元)						(千中国元)					
決 算 期	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期			
純 資 産	766,068 (11,675百万円)	786,208 (11,982百万円)	1,051,334 (16,022百万円)	102,830 (1,567百万円)	192,749 (2,937百万円)	243,541 (3,712百万円)	602,736 (0百万円)	602,736 (9,186百万円)	1,557,077 (23,730百万円)			
総 資 産	1,419,438 (21,632百万円)	1,681,883 (25,632百万円)	2,249,406 (34,281百万円)	160,442 (2,445百万円)	307,247 (4,682百万円)	425,543 (6,485百万円)	603,616 (0百万円)	603,616 (9,199百万円)	1,915,042 (29,185百万円)			
1 株 あ た り 純 資 産	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)			
売 上 高	1,775,181 (27,054百万円)	1,929,803 (29,410百万円)	1,992,065 (30,359百万円)	(0百万円)	254,156 (3,873百万円)	343,491 (5,235百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)			
経 常 利 益	239,385 (3,648百万円)	301,657 (4,597百万円)	337,897 (5,150百万円)	1,446 (22百万円)	57,593 (878百万円)	114,926 (1,751百万円)	(0百万円)	-5,587 (-85百万円)	6,533 (100百万円)			
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失	204,432 (3,116百万円)	256,716 (3,912百万円)	233,364 (3,556百万円)	1,446 (22百万円)	42,255 (644百万円)	99,530 (1,517百万円)	(0百万円)	-5,587 (-85百万円)	4,900 (75百万円)			
1 株 あ た り 配 当 金	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)			

注1) 中国の子会社につきましては、有限公司の為、株式という概念がないことから1株あたりの純資産、配当金の表記を省略しております。

注2) 円換算レートは、2019年8月5日時点の三菱UFJ銀行公表仲値為替レート CNY/JPY=15.24/HKD/JPY=13.59/USD/JPY=106.35 を使用しております。(百万円未満切り捨て)

<別紙 2/3>

(1) 名 称	杭州中芯晶圆半导体股份有限公司			上海申和熱磁電子有限公司			上海漢虹精密機械有限公司					
(2) 所 在 地	中国浙江省			中国上海市			中国上海市					
(3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	董事長 賀 賢漢			董事長 山 村 章			董事長 賀 賢漢					
(4) 事 業 内 容	半導体等装置関連事業			半導体等装置関連事業、電子デバイス事業、太陽電池事業			太陽電池関連事業その他					
(5) 資 本 金	1,557,764千中国元			1,241,187千中国元			266,051千中国元					
(6) 設 立 年 月 日	2017/9/28			1995/5/17			2005/3/11					
(7) 議 決 権 の 所 有 割 合 () 内 は 間 接 所 有 の 割 合	100.00% (23.75%)			100.00%			100.00%(100.00%)					
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	間接所有23.75%を含む当社100%出資の連結子会社			資 本 関 係	当社100%出資の連結子会社			資 本 関 係	当社間接所有100.00%の連結子会社		
	人 的 関 係	当社の取締役3名が同社の董事を兼任			人 的 関 係	当社の取締役2名が同社の董事を兼任			人 的 関 係	当社の取締役2名が同社の董事を兼任		
	取 引 関 係	当社は資材等の購買代行、債務保証をしています			取 引 関 係	当社は資材等の購買代行、債務保証、資金貸付をしています			取 引 関 係	当社は資材等の購買代行、資金貸付をしています		
(9) 最近3か年の経営成績及び財政状態	(千中国元)						(千中国元)					
決 算 期	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期			
純 資 産		602,736	1,557,077	940,003	1,035,245	1,220,950	112,904	101,768	39,160			
	(0百万円)	(9,186百万円)	(23,730百万円)	(14,326百万円)	(15,777百万円)	(18,607百万円)	(1,721百万円)	(1,551百万円)	(597百万円)			
総 資 産		603,616	1,915,042	1,682,437	1,844,028	2,112,588	342,982	332,671	326,047			
	(0百万円)	(9,199百万円)	(29,185百万円)	(25,640百万円)	(28,103百万円)	(32,196百万円)	(5,227百万円)	(5,070百万円)	(4,969百万円)			
1 株 あ た り 純 資 産		(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)			
売 上 高				1,326,452	1,559,037	941,948	147,907	103,643	304,303			
	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(20,215百万円)	(23,760百万円)	(14,355百万円)	(2,254百万円)	(1,580百万円)	(4,638百万円)			
経 常 利 益		-5,587	6,533	-9,837	42,133	-9,824	-38,360	-2,071	20,614			
	(0百万円)	(-85百万円)	(100百万円)	(-150百万円)	(642百万円)	(-150百万円)	(-585百万円)	(-32百万円)	(314百万円)			
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失		-5,587	4,900	-11,427	34,329	-52,322	-38,360	-2,071	20,614			
	(0百万円)	(-85百万円)	(75百万円)	(-174百万円)	(523百万円)	(-797百万円)	(-585百万円)	(-32百万円)	(314百万円)			
1 株 あ た り 配 当 金		(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)			

(1) 名 称	寧夏銀和半導体科技有限公司			香港第一半導体科技股份有限公司			Ferrotec (USA) Corporation					
(2) 所 在 地	中国銀川市			香港			米国					
(3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	董事長 賀 賢漢			董事長 賀 賢漢			President & CEO 宮永 英治					
(4) 事 業 内 容	半導体等装置関連事業			太陽電池関連事業			半導体等装置関連事業、電子デバイス事業					
(5) 資 本 金	200,000千中国元			359,072千香港ドル			41,611千米ドル					
(6) 設 立 年 月 日	2015/12/14			2008/3/28			1968/10/15					
(7) 議 決 権 の 所 有 割 合 () 内 は 間 接 所 有 の 割 合	100.00%(100.00%)			100.00%			100.00%					
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社間接所有100.00%の連結子会社			資 本 関 係	当社100%出資の連結子会社			資 本 関 係	当社100%出資の連結子会社		
	人 的 関 係	当社の取締役1名が同社の董事を兼任			人 的 関 係	当社の取締役2名が同社の董事を兼任			人 的 関 係	当社の取締役3名が同社の役員を兼任		
	取 引 関 係	当社は資材等の購買代行、債務保証、資金貸付をしています			取 引 関 係	当社は貸付をしています			取 引 関 係	記載すべき取引関係はありません		
(9) 最近3か年の経営成績及び財政状態	(千中国元)						(千米ドル)					
決 算 期	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期			
純 資 産	20,015 (305百万円)	81,827 (1,247百万円)	117,087 (1,784百万円)	260,576 (3,971百万円)	260,221 (3,966百万円)	259,455 (3,954百万円)	41,975 (4,464百万円)	42,722 (4,543百万円)	49,606 (5,276百万円)			
総 資 産	22,588 (344百万円)	228,026 (3,475百万円)	858,447 (13,083百万円)	270,541 (4,123百万円)	269,961 (4,114百万円)	269,687 (4,110百万円)	80,696 (8,582百万円)	94,950 (10,098百万円)	105,258 (11,194百万円)			
1 株 あ た り 純 資 産	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	35.68 (3.8百万円)	36.31 (3.9百万円)	42.17 (4.5百万円)			
売 上 高	(0百万円)	3,820 (58百万円)	94,271 (1,437百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	151,737 (16,137百万円)	201,725 (21,453百万円)	244,144 (25,965百万円)			
経 常 利 益	15 (0百万円)	-18,187 (-277百万円)	-64,740 (-987百万円)	-2,635 (-40百万円)	-354 (-5百万円)	-766 (-12百万円)	5,302 (564百万円)	12,430 (1,322百万円)	17,566 (1,868百万円)			
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失	15 (0百万円)	-18,187 (-277百万円)	-64,740 (-987百万円)	-2,635 (-40百万円)	-354 (-5百万円)	-766 (-12百万円)	2,665 (283百万円)	5,447 (579百万円)	13,621 (1,449百万円)			
1 株 あ た り 配 当 金	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	(0百万円)	1.275 (136千円)	3.996 (425千円)	6.394 (680千円)			